

# 2022-2028年中国芯片设计 市场深度分析与市场年度调研报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202206/302515.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》共十一章。首先介绍了芯片设计行业市场发展环境、芯片设计整体运行态势等，接着分析了芯片设计行业市场运行的现状，然后介绍了芯片设计市场竞争格局。随后，报告对芯片设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片设计行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片设计产业有个系统的了解或者想投资芯片设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 芯片设计行业相关概述

#### 1.1 芯片的概念和分类

##### 1.1.1 芯片基本概念

##### 1.1.2 相关概念区分

##### 1.1.3 芯片主要分类

#### 1.2 芯片产业链结构

##### 1.2.1 芯片产业链结构

##### 1.2.2 芯片生产流程图

##### 1.2.3 产业链核心环节

#### 1.3 芯片设计行业概述

##### 1.3.1 芯片设计行业简介

##### 1.3.2 芯片设计基本分类

##### 1.3.3 芯片设计产业图谱

### 第二章 2016-2020年中国芯片设计行业发展环境

#### 2.1 经济环境

##### 2.1.1 宏观经济发展概况

##### 2.1.2 工业经济运行情况

##### 2.1.3 经济转型升级态势

- 2.1.4 未来经济发展展望
- 2.2 政策环境
  - 2.2.1 智能制造发展战略
  - 2.2.2 中国制造支持政策
  - 2.2.3 集成电路相关政策
  - 2.2.4 芯片产业政策汇总
  - 2.2.5 产业投资基金支持
- 2.3 社会环境
  - 2.3.1 移动网络运行状况
  - 2.3.2 电子信息制造规模
  - 2.3.3 研发经费投入增长
  - 2.3.4 科技人才队伍壮大
- 2.4 技术环境
  - 2.4.1 芯片领域专利状况
  - 2.4.2 芯片技术数量分布
  - 2.4.3 芯片技术研发进展
  - 2.4.4 芯片技术创新升级
  - 2.4.5 芯片技术发展方向

### 第三章 2016-2020年中国芯片产业发展分析

- 3.1 2016-2020年中国芯片产业发展综述
  - 3.1.1 产业基本特征
  - 3.1.2 产业发展背景
  - 3.1.3 产业发展意义
  - 3.1.4 产业发展进程
  - 3.1.5 产业发展提速
- 3.2 2016-2020年中国芯片市场运行状况
  - 3.2.1 产业销售规模
  - 3.2.2 市场结构分析
  - 3.2.3 产品产量规模
  - 3.2.4 企业竞争状况
  - 3.2.5 区域发展格局

- 3.2.6 市场应用需求
- 3.3 2016-2020年中国集成电路所属行业进出口数据分析
  - 3.3.1 进出口总量数据分析
  - 3.3.2 主要贸易国进出口情况分析
  - 3.3.3 主要省市进出口情况分析
- 3.4 2016-2020年中国芯片国产化进程分析
  - 3.4.1 芯片国产化发展背景
  - 3.4.2 核心芯片的自给率低
  - 3.4.3 芯片国产化进展分析
  - 3.4.4 芯片国产化存在问题
  - 3.4.5 芯片国产化未来展望
- 3.5 中国芯片产业发展困境分析
  - 3.5.1 市场垄断困境
  - 3.5.2 过度依赖进口
  - 3.5.3 技术短板问题
  - 3.5.4 人才短缺问题
- 3.6 中国芯片产业应对策略分析
  - 3.6.1 突破垄断策略
  - 3.6.2 化解供给不足
  - 3.6.3 加强自主创新
  - 3.6.4 加大资源投入

#### 第四章 2016-2020年芯片设计行业发展全面分析

- 4.1 2016-2020年全球芯片设计行业发展综述
  - 4.1.1 市场发展规模
  - 4.1.2 市场区域格局
  - 4.1.3 市场竞争格局
  - 4.1.4 企业排名分析
- 4.2 2016-2020年中国芯片设计行业运行状况
  - 4.2.1 行业发展历程
  - 4.2.2 市场发展规模
  - 4.2.3 市场竞争格局

- 4.2.4 产品类型分布
- 4.2.5 细分市场发展
- 4.3 芯片设计企业发展状况分析
  - 4.3.1 企业数量规模
  - 4.3.2 企业运行状况
  - 4.3.3 企业地域分布
  - 4.3.4 设计人员规模
- 4.4 芯片设计行业上市公司财务状况分析
  - 4.4.1 上市公司规模
  - 4.4.2 上市公司分布
  - 4.4.3 经营状况分析
  - 4.4.4 盈利能力分析
  - 4.4.5 营运能力分析
  - 4.4.6 成长能力分析
  - 4.4.7 现金流量分析
- 4.5 芯片设计具体流程剖析
  - 4.5.1 规格制定
  - 4.5.2 设计细节
  - 4.5.3 逻辑设计
  - 4.5.4 电路布局
  - 4.5.5 光罩制作
- 4.6 芯片设计行业发展存在的问题和对策
  - 4.6.1 行业发展瓶颈
  - 4.6.2 行业发展困境
  - 4.6.3 产业发展建议
  - 4.6.4 产业创新策略

## 第五章 2016-2020年中国芯片设计行业细分产品发展分析

- 5.1 逻辑IC产品设计发展状况
  - 5.1.1 CPU
  - 5.1.2 GPU
  - 5.1.3 MCU

- 5.1.4 ASIC
- 5.1.5 FPGA
- 5.1.6 DSP
- 5.2 存储IC产品设计发展状况
  - 5.2.1 DRAM
  - 5.2.2 NAND Flash
  - 5.2.3 NOR Flash
- 5.3 模拟IC产品设计发展状况
  - 5.3.1 射频器件
  - 5.3.2 模数/数模转换器
  - 5.3.3 电源管理产品

## 第六章 中国芯片设计工具&mdash;&mdash;EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况

- 6.1 EDA软件基本概述
  - 6.1.1 EDA软件基本概念
  - 6.1.2 EDA软件的重要性
  - 6.1.3 EDA软件主要类型
  - 6.1.4 EDA软件设计过程
  - 6.1.5 EDA软件设计步骤
- 6.2 中国芯片设计EDA软件行业发展分析
  - 6.2.1 行业发展规模
  - 6.2.2 市场竞争状况
  - 6.2.3 国产EDA机遇
  - 6.2.4 行业发展瓶颈
  - 6.2.5 行业发展对策
- 6.3 集成电路EDA行业竞争状况
  - 6.3.1 市场竞争格局
  - 6.3.2 国际EDA企业
  - 6.3.3 国内EDA企业
- 6.4 EDA技术及工具发展沿革及作用
  - 6.4.1 GDS&GDS II
  - 6.4.2 SPICE

6.4.3 半导体器件模型 ( SPICE Model )

6.4.4 硬件描述语言 ( HDL )

6.4.5 静态时序分析

## 第七章 中国芯片设计产业园区建设分析

### 7.1 深圳集成电路设计应用产业园

7.1.1 园区发展环境

7.1.2 园区基本简介

7.1.3 园区战略定位

7.1.4 园区服务内容

### 7.2 北京中关村集成电路设计园

7.2.1 园区发展环境

7.2.2 园区基本简介

7.2.3 园区战略定位

7.2.4 园区发展状况

7.2.5 园区企业合作

7.2.6 园区发展规划

### 7.3 上海集成电路设计产业园

7.3.1 园区发展环境

7.3.2 园区基本简介

7.3.3 园区入驻企业

7.3.4 园区项目建设

7.3.5 园区发展规划

### 7.4 无锡国家集成电路设计产业园

7.4.1 园区发展环境

7.4.2 园区基本简介

7.4.3 园区发展状况

7.4.4 园区区位优势

### 7.5 杭州集成电路设计产业园

7.5.1 园区发展环境

7.5.2 园区基本简介

7.5.3 园区签约项目

#### 7.5.4 园区发展规划

### 第八章 国外芯片设计重点企业经营状况

#### 8.1 博通 (Broadcom)

##### 8.1.1 企业发展概况

##### 8.1.2 企业经营状况

##### 8.1.3 产品研发动态

##### 8.1.4 企业发展战略

#### 8.2 高通 (Qualcomm)

##### 8.2.1 企业发展概况

##### 8.2.2 企业经营状况

##### 8.2.3 产品研发动态

##### 8.2.4 企业发展战略

#### 8.3 英伟达 (NVIDIA)

##### 8.3.1 企业发展概况

##### 8.3.2 企业经营状况

##### 8.3.3 产品研发动态

##### 8.3.4 企业发展战略

#### 8.4 超微 (AMD)

##### 8.4.1 企业发展概况

##### 8.4.2 企业经营状况

##### 8.4.3 产品研发动态

##### 8.4.4 企业发展战略

#### 8.5 赛灵思 (Xilinx)

##### 8.5.1 企业发展概况

##### 8.5.2 企业经营状况

##### 8.5.3 产品研发动态

##### 8.5.4 企业发展战略

### 第九章 国内芯片设计重点企业经营状况

#### 9.1 联发科

##### 9.1.1 企业发展概况

- 9.1.2 企业经营状况
- 9.1.3 企业芯片平台
- 9.1.4 企业研发项目
- 9.2 华为海思
  - 9.2.1 企业发展概况
  - 9.2.2 企业经营状况
  - 9.2.3 企业芯片平台
  - 9.2.4 企业研发项目
- 9.3 紫光展锐
  - 9.3.1 企业发展概况
  - 9.3.2 企业经营状况
  - 9.3.3 企业芯片平台
  - 9.3.4 企业研发项目
- 9.4 中兴微电子
  - 9.4.1 企业发展概况
  - 9.4.2 企业经营状况
  - 9.4.3 企业芯片平台
  - 9.4.4 企业研发项目
- 9.5 华大半导体
  - 9.5.1 企业发展概况
  - 9.5.2 企业发展状况
  - 9.5.3 企业芯片平台
  - 9.5.4 企业研发项目
- 9.6 汇顶科技
  - 9.6.1 企业发展概况
  - 9.6.2 经营效益分析
  - 9.6.3 企业芯片平台
  - 9.6.4 企业研发项目
- 9.7 兆易创新
  - 9.7.1 企业发展概况
  - 9.7.2 经营效益分析
  - 9.7.3 企业芯片平台

#### 9.7.4 企业研发项目

### 第十章 对芯片设计行业投资价值综合分析

#### 10.1 对集成电路产业投资价值评估及投资建议

##### 10.1.1 投资价值综合评估

##### 10.1.2 市场机会矩阵分析

##### 10.1.3 产业进入时机分析

##### 10.1.4 产业投资风险剖析

##### 10.1.5 产业投资策略建议

#### 10.2 对芯片设计行业进入壁垒评估

##### 10.2.1 行业竞争壁垒

##### 10.2.2 行业技术壁垒

##### 10.2.3 行业资金壁垒

#### 10.3 对芯片设计行业投资状况分析

##### 10.3.1 产业投资规模

##### 10.3.2 产业投资热点

##### 10.3.3 基金投资策略

##### 10.3.4 投资项目分析

### 第十一章 对2022-2028年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析 ( )

#### 11.1 中国芯片市场发展机遇分析

##### 11.1.1 产业发展机遇分析

##### 11.1.2 市场变动带来机遇

##### 11.1.3 产业未来发展趋势

#### 11.2 中国芯片设计行业发展前景展望

##### 11.2.1 技术创新发展

##### 11.2.2 市场需求状况

##### 11.2.3 行业发展前景

#### 11.3 对2022-2028年中国芯片设计行业预测分析

##### 11.3.1 2022-2028年中国芯片设计行业影响因素分析

##### 11.3.2 2022-2028年中国芯片设计行业销售规模预测

## 部分图表目录：

- 图表1 芯片产品分类
  - 图表2 集成电路产业链及部分企业
  - 图表3 芯片生产历程
  - 图表4 芯片设计产业图谱
  - 图表5 2016-2020年国内生产总值及其增长速度
  - 图表6 2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值比重
  - 图表7 2020年中国GDP核算数据
  - 图表8 2020年规模以上工业增加值至同比增长速度
  - 图表9 2020年规模以上工业生产主要数据
  - 图表10 2016-2020年规模以上工业增加值同比增长速度
  - 图表11 2020年规模以上工业生产主要数据
  - 图表12 智能制造系统架构
  - 图表13 智能制造系统层级
  - 图表14 MES制造执行与反馈流程
  - 图表15 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持
  - 图表16 2016-2020年IC产业政策目标与发展重点
  - 图表17 国家支持集成电路产业发展的部分重点政策
  - 图表18 中国芯片产业相关政策汇总（一）
  - 图表19 中国芯片产业相关政策汇总（二）
  - 图表20 一期大基金投资各领域份额占比
  - 图表21 2016-2020年中国网民规模和互联网普及率
  - 图表22 2016-2020年手机网民规模及其占网民比例
  - 图表23 2016-2020年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速
  - 图表24 2016-2020年电子信息制造业主营业务收入、利润增速变动情况
  - 图表25 2016-2020年电子信息制造业PPI分月增速
  - 图表26 2016-2020年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况
  - 图表27 2016-2020年通信设备行业增加值和出口交货值分月增速
  - 图表28 2016-2020年电子元件行业增加值和出口交货值分月增速
  - 图表29 2016-2020年电子器件行业增加值和出口交货值分月增速
  - 图表30 2016-2020年计算机制造业增加值和出口交货值分月增速
- 更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202206/302515.html>